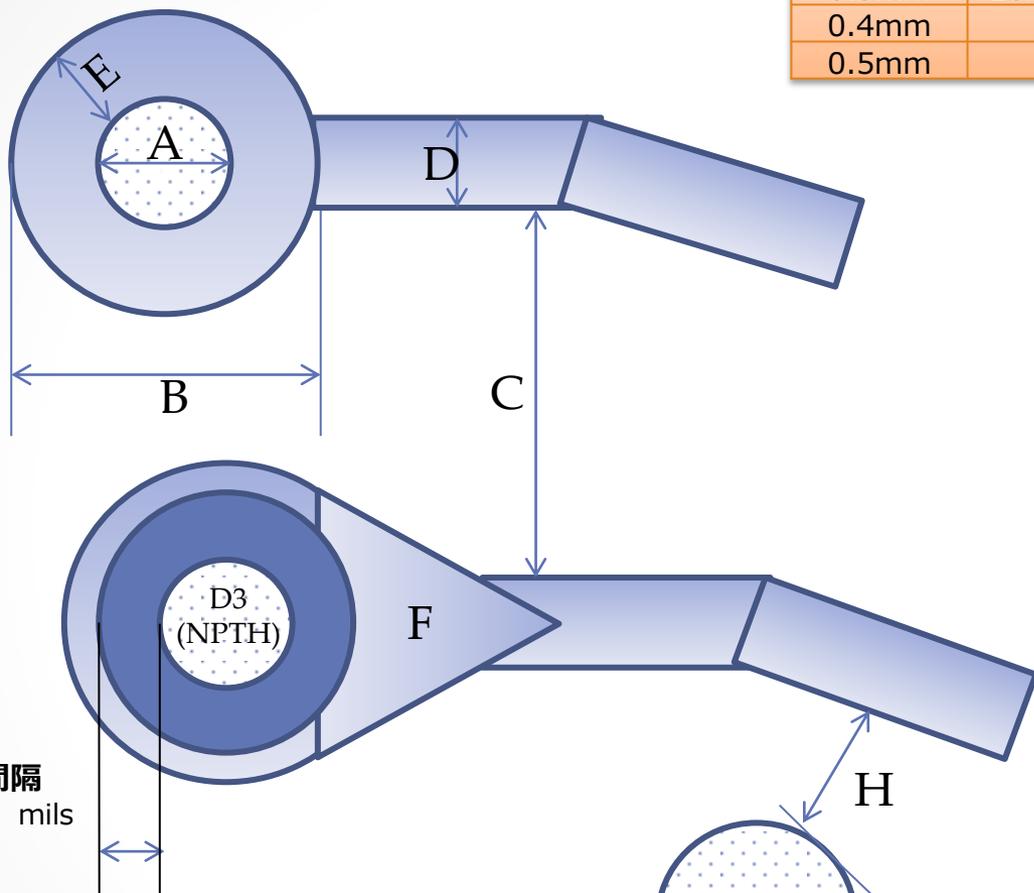


デザイン仕様案内(PATTERN)

VIA SIZE & ROUND (公差値+0.1mm適用サイズ)		部品穴は公差値+0.1mm適用後、最小"E"サイズ 4 milsになります。Teardropは推奨"F" 基本 6 mils以上に設定
A	B (最小)	
0.2mm	16mils(14.5)	
0.3mm	20mils(18.5)	
0.4mm	25mils	
0.5mm	29mils	



穴とランド間隔
8 (最小 6) mils

ハツデ
pcb
2011.12 Rev1 updated.
2012.12 Doc. Updated.

銅箔厚みによるパターン幅・間隔			
	C (最小)	D (最小)	
BGA(0.5 Pitch)	70 μ m	70 μ m	打合せ
HOZ(18 μ m)	4mils	4mils	
1OZ(35 μ m)	5mils	6mils(5)	
2OZ(70 μ m)	7mils(6)	7mils(6)	

NPTH Cu clearance	
DIRLL "G"	"H" (最小)
1.5mm 以下	8mils(6)
1.6mm 以上	10mils(8)